

mini-PFE 100 / 200

Cellule propre physique de précision



Équipement capable de traiter automatiquement en continu les surfaces supérieure et inférieure des pièces en forme de bande

La petite cellule utilisant un canon large est utilisée pour l'industrie électrique telle que les cartes de circuits imprimés ou les semi-conducteurs. En traitant uniformément les deux côtés, il peut s'appliquer à la forme de la tige et à la forme de la feuille. Applicable pour la céramique et la plaque Cu.

Fonctionnalité

- Les fonctions sont intégrées, mais sa qualité de traitement par sablage humide reste telle quelle. Cellule nouvellement développée comme un objectif de petite taille et économique.
- Les pièces compactes de sablage et de rinçage à l'eau facilitent la maintenance des actionneurs ; en ouvrant simplement un couvercle de convoyeur. De plus, le pistolet large et la pompe en tant que pièces principales conservent toujours la grande durabilité d'origine.
- Gamme de 2 types (mini PFE 100/200) selon la taille de la pièce.

Spécification

mini PFE 100

Taille	1200(W)×1250(D)×1600(H)mm
Taille de travail	Largeur : 20-100mm Longueur : 100-250mm Épaisseur : 0.1-1.5mm
Vitesse de transport du convoyeur	0.1~3.0m/minute
Pistolet	Pistolet large 110 mm Un chacun pour le haut et le bas
Source de courant	AC200V, 50/60Hz, 3 phases
Consommation d'énergie	Environ 2,6 kW (Puissance apparente nominale totale de tous les équipements)
Pression d'alimentation en air	0.5MPa-0.7MPa
Consommation d'air	4.1m ³ /min (NTP à 0,25 MPa de pression d'air de soufflage prédéfinie)

mini-PFE 200

Taille	1200(W)×1650(D)×1650(H)mm
Taille de travail	Largeur : 20-200mm Longueur : 100-250mm Épaisseur : 0.1-1.5mm
Vitesse de transport du convoyeur	0.1~3.0m/min
Pistolet	Pistolet large 220 mm Un chacun pour le haut et le bas
Source de courant	AC200V, 50/60Hz, 3 phases

Consommation d'énergie

Environ 4,3 kW (Puissance apparente nominale totale de tous les équipements)

Pression d'alimentation en air

0.5MPa-0.7MPa

Consommation d'air

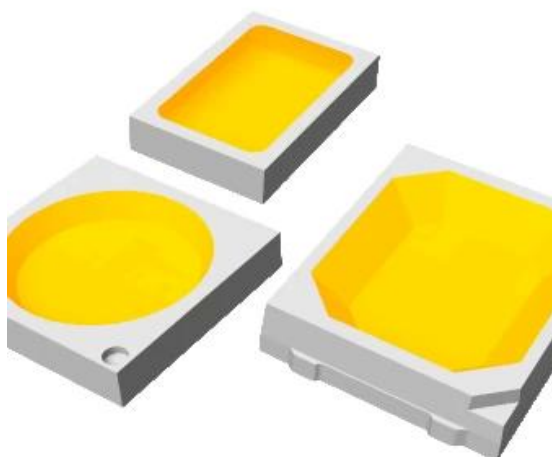
7.7m³/min (NTP à 0,25 MPa de pression d'air de soufflage prédéfinie)

Pages associées

Applications connexes



[Prétraitement pour le placage pour éliminer les bavures sans endommager les semi-conducteurs \(ébavurage\)](#)



[Méthode d'élimination de la résine surmoulée qui réduit considérablement les dommages aux puces LED enterrées](#)



[Méthode de traitement pour éliminer les bavures fines \(bavures flash\) sans endommager le boîtier LED](#)